

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

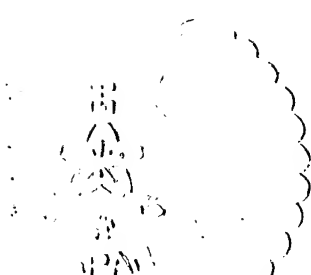
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 2 年 1 0 月 1 5 日  
Date of Application:

出 願 番 号            特 願 2 0 0 2 - 3 0 0 1 8 3  
Application Number:

[ST. 10/C] :-            [ J P 2 0 0 2 - 3 0 0 1 8 3 ]

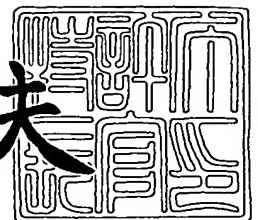
出      願      人            セイコーエプソン株式会社  
Applicant(s):



2 0 0 3 年 1 0 月 2 2 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P2187EP

【提出日】 平成14年10月15日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/314

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 宮川 拓也

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091306

【弁理士】

【氏名又は名称】 村上 友一

【選任した代理人】

【識別番号】 100086922

【弁理士】

【氏名又は名称】 大久保 操

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002196

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多孔質絶縁膜の形成方法および装置並びにその形成方法を用いて製造した電子デバイス

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 絶縁材原料を溶解させた溶液をワークに塗布する溶液塗布工程と、

前記ワークに塗布した前記溶液を溶媒の融点以下に冷却して固相にする凝固膜形成工程と、

凝固膜中の前記溶媒を除去して多孔膜にする乾燥工程と、

乾燥した多孔質凝固膜を硬化する焼成工程と、

を有することを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の多孔質絶縁膜の形成方法において、前記乾燥工程は、減圧下で行なうことを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載の多孔質絶縁膜の形成方法において、

前記凝固膜形成工程は、前記ワークに塗布した前記溶液中の前記溶媒の一部を除去したのちに行なうことを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 4】 請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかに記載の多孔質絶縁膜の形成方法において、

前記焼成工程後に、硬化させた前記多孔質凝固膜の通気性を除去する気密処理をすることを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 5】 請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかに記載の多孔質絶縁膜の形成方法において、前記凝固膜形成工程は、前記溶液を急冷して行なうことを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 6】 請求項 1 ないし請求項 5 のいずれかに記載の多孔質絶縁膜の形成方法において、

前記ワークへの前記溶液の塗布は、スリットコートにより行なうことを特徴とする多孔質絶縁膜の形成方法。

【請求項 7】 絶縁材原料を溶解させた溶液をワークに塗布する溶液塗布部

と、

前記ワークに塗布した前記溶液を溶媒の融点以下に冷却する凝固膜形成部と、  
凝固膜中の前記溶媒を減圧して除去する真空乾燥部と、  
乾燥した多孔質の前記凝固膜を硬化する焼成部と、  
を有することを特徴とする多孔質絶縁膜形成装置。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の多孔質絶縁膜形成装置において、  
前記凝固膜形成部は、前記真空乾燥部の減圧室内に設けてあることを特徴とする  
多孔質絶縁膜形成装置。

【請求項 9】 請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかに記載の多孔質絶縁膜の  
形成方法により形成した多孔質絶縁膜を備えたことを特徴とする電子デバイス。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、大規模集積回路（L S I）の層間絶縁膜などに好適な低誘電率絶縁  
膜を形成する方法に係り、特に多数の微細な空孔を有する多孔質絶縁膜の形成方  
法およびその装置並びにその形成方法を用いて製造した電子デバイスに関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、電子デバイスである半導体装置は、動作速度の高速化、小型化、高集積  
化が図られており、素子が多層に形成してある。そして、半導体装置は、小型化  
、高集積化を実現するために、素子を微細化するとともに、配線間の距離が短く  
なり、配線間を電氣的に分離する層間絶縁膜の幅が狭くなる。ところが、層間絶  
縁膜の幅（ギャップ）が狭くなると、層間絶縁膜の静電容量が増大し、半導体装  
置の高速動作の障害となる。このため、層間絶縁膜を低誘電率の材料（いわゆる  
L o w - k 材）によって形成することが種々検討されている。この層間絶縁膜を  
低誘電率化する方法として、層間絶縁膜をメソポーラスシリカによって形成する  
ことが提案されている（特許文献 1）。

【0 0 0 3】

【特許文献 1】

特開 2002-53773 号公報

## 【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

ところが、特許文献 1 に記載されている層間絶縁膜の形成方法は、(1) 超微粒子メソポーラスシリカの合成、(2) 超微粒子メソポーラスシリカの分離回収、(3) 超微粒子メソポーラスシリカの表面処理、(4) 超微粒子メソポーラスシリカを溶媒に溶解する塗布液の調整、(5) ワークへの塗布液の塗布、(6) 塗布液の加熱、乾燥、と多くの複雑な工程を経る必要があり、層間絶縁膜を形成するために多くの時間を必要とする。

## 【0005】

本発明は、前記従来技術の欠点を解消するためになされたもので、多孔質絶縁膜を容易に形成できるようにすることを目的としている。

また、本発明は、低誘電率の絶縁膜を容易に形成できるようにすることを目的としている。

## 【0006】

## 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明に係る多孔質絶縁膜の形成方法は、絶縁材原料を溶解させた溶液をワークに塗布する溶液塗布工程と、前記ワークに塗布した前記溶液を溶媒の融点以下に冷却して固相にする凝固膜形成工程と、凝固膜中の前記溶媒を除去して多孔膜にする乾燥工程と、乾燥した多孔質凝固膜を硬化する焼成工程と、を有することを特徴としている。

## 【0007】

このようになっている本発明は、例えば二酸化ケイ素 ( $\text{SiO}_2$ ) の微粉末やテトラエトキシシラン (TEOS) などの絶縁材原料を溶解した溶液をワークに塗布し、これを溶媒の融点以下に冷却して溶液を凝固膜にする (いわゆる凍結する)。その後、凝固膜を乾燥して溶媒を除去して多孔膜にし、さらに焼成することにより、多孔質の絶縁膜を形成する。すなわち、本発明は、絶縁材原料の溶液をいわゆる凍結乾燥して焼成することにより、多孔質絶縁膜を少ない工程で容易に、また比較的短時間に形成することができる。しかも、溶液をいわゆる凍結乾

燥することにより、絶縁膜中に微細な空孔（気泡）を多数形成することができ、空孔率を90%以上とすることが可能で、非常に誘電率の低い絶縁膜とすることができる。また、本発明は、溶液を塗布してこれをいわゆる凍結乾燥して多孔質絶縁膜を形成するため、ワークの表面に凹凸が形成されている場合に、凹部が溶液によって埋められるため、多孔質絶縁膜の形成と同時にワークの表面を平坦化することができる。

#### 【0008】

乾燥工程は、減圧下で行なうとよい、減圧下で乾燥（いわゆる真空乾燥）を行なうことにより、乾燥時間を大幅に短縮することができる。凝固膜形成工程は、ワークに塗布した溶液中の溶媒の一部を除去したのちに行なうことができる。溶液を凍結して得た凝固膜は、塗布した溶液の厚さとほとんど変わらない厚さとなる。従って、凝固膜の形成前に溶液中の溶媒の一部を蒸発させることにより、溶液の塗布膜の厚を減ずることができ、凝固膜の膜厚、すなわち多孔質絶縁膜の膜厚を調整することが可能となる。

#### 【0009】

本発明は、焼成工程後に、硬化させた多孔質凝固膜の通気性を除去する気密処理を行なうことが望ましい。いわゆる凍結乾燥により形成した多孔質絶縁膜は、空孔率が非常に高く、多孔質絶縁膜が薄い場合、膜の一侧と他側との間で通気性を有する場合が多い。このため、多孔質絶縁膜が空気中の水分子の付着により導通したり、絶縁性能が低下する。そこで、焼成工程後に、気密処理をして硬化させた多孔質凝固膜（多孔質絶縁膜）の通気性を遮断する。これにより、多孔質絶縁膜の絶縁性能の劣化を防ぐことができる。具体的には、フラッシュ法やレーザーなどによって多孔質絶縁膜の表面を瞬間的に高温に晒し、表層部を溶融して表層部の空孔を塞ぐ。

#### 【0010】

凝固膜形成工程は、溶液を急冷して行なうことができる。溶液の溶媒が沸点の低い場合、急冷することにより、溶媒の蒸発（揮発）による膜圧の変動をを防止し、所望の厚さの凝固膜とすることができる。そして、ワークへの溶液の塗布は、スリットコートにより行なうとよい。スリットコートは、微小なノズルまたは

微小間隔のノズルから、毛細管現象を利用して溶液を滲み出すように吐出させて塗布するため、溶液の利用効率を高くすることができる。

#### 【0011】

そして、本発明に係る多孔質絶縁膜形成装置は、絶縁材原料を溶解させた溶液をワークに塗布する溶液塗布部と、前記ワークに塗布した前記溶液を溶媒の融点以下に冷却する凝固膜形成部と、凝固膜中の前記溶媒を減圧して除去する真空乾燥部と、乾燥した多孔質の前記凝固膜を硬化する焼成部と、を有することを特徴としている。これにより、上記の多孔質絶縁膜の形成方法を容易、確実に実施することができる。なお、凝固膜形成部は、真空乾燥部の減圧室内に設けることができる。これにより、装置の小型化が図れ、工程を簡略化することができる。

#### 【0012】

また、本発明に係る電子デバイスは、上記の多孔質絶縁膜の形成方法により形成した多孔質絶縁膜を備えたことを特徴としている。これにより、上記の効果を有する半導体装置や液晶パネルなどの電子デバイスを得ることができる。

#### 【0013】

##### 【発明の実施の形態】

本発明に係る多孔質絶縁膜の形成方法および装置並びにその形成方法を用いて製造した電子デバイスの好ましい実施の形態を、添付図面に従って詳細に説明する。

図1は、本発明に係る多孔質絶縁膜形成装置の概略構成図である。図1において、多孔質絶縁膜形成装置10は、溶液塗布部20を有する。溶液塗布部20は、二酸化ケイ素の微粉末やアルコキシド系化合物などの絶縁材原料を溶解した溶液22を貯留した塗布液槽24を備えている。この塗布液槽24内の溶液22は、塗布ノズルであるキャピラリー26によって、半導体基板やガラス基板などのワーク1に塗布される。

#### 【0014】

すなわち、溶液塗布部20は、図2(1)に示したように、ワーク1を真空吸着などによって支持するチャック30を有し、このチャック30が矢印32のよう図2の左右方向に移動可能となっている。そして、ワーク1は、チャック3

0の下面に保持され、チャック30によって塗布液槽24の上方を通過するようになっている。また、キャピラリー26は、矢印34のように昇降可能となっており、待機時には溶液22中に没するようになっている。キャピラリー26は、図2の紙面と直交した方向が長手方向となるスリット状に形成してあり、長さがワーク1の幅より長くなっている。

#### 【0015】

一方、塗布液槽24の上端開口36には、開閉自在な蓋38が配置してある。この蓋38は、塗布液槽24内の溶液22中の溶媒が蒸発するのを阻止し、溶液22の濃度が変動するのを防止する。そして、キャピラリー26は、先端（上端）が塗布液槽24の上端開口36から出沒するようになっている。キャピラリー26は、開口幅dが例えば5～6 $\mu$ m程度に形成してあって、後述するように、毛細管現象により溶液22を吐出する。すなわち、実施形態の場合、溶液塗布部20は、いわゆるスリットコート法によって溶液22をワーク1に塗布するようになっている。ただし、溶液22のワーク1への塗布は、スピンコート、はけ塗り、ディップ法などによって行なってもよい。

#### 【0016】

多孔質絶縁膜形成装置10は、図1に示したように、凝固膜形成部50、真空乾燥部60、焼成部70、気密処理部80を備えている。凝固膜形成部50は、実施形態の場合、冷却コイル52を備えた金属製の冷却プレート54によって構成してある。冷却プレート54は、ワーク1に塗布された溶液22を溶媒の融点以下に急冷してゲル状の凝固膜68にする。また、真空乾燥部60は、ワーク1を配置する減圧室62を有している。この減圧室62は、ゲル状の凝固膜68をいわゆる凍結真空乾燥して多孔質化するためのもので、排気管64を介して真空ポンプ66に接続してある。従って、減圧室62は、真空ポンプ66が駆動されることにより、内部が減圧されて真空となる。なお、実施形態の場合、凝固膜形成部50は、真空乾燥部60の減圧室62の内部に設置してある。これにより、装置の小型化、ワーク1の搬送工程の簡素化が図れる。もちろん、凝固膜形成部50は、減圧室62の外部に設けることができる。

#### 【0017】



一方、焼成部 70 は、実施形態の場合、ヒータ 72 を内蔵したホットプレート 74 からなっている。しかし、焼成部 70 は、トンネル炉や赤外線照射装置などによって構成してもよい。この焼成部 70 は、真空乾燥部 60 において多孔質となった凝固膜（多孔質凝固膜）76 を、ホットプレート 74 によって加熱して硬化する。そして、焼成部 70 の後段に設けた気密処理部 80 は、ワーク 1 を配置する処理室 82 を有する。この処理室 82 の上部には、フラッシュ装置 84 が設けてある。フラッシュ装置 84 は、瞬間的に熱線を放射し、硬化した多孔質凝固膜（多孔質絶縁膜）86 の表面を瞬間的に高温に晒し、多孔質絶縁膜 86 の表層部を熔融して表層部の空孔（図示せず）を塞ぐ。なお、フラッシュ装置 84 に代えて、レーザ照射装置などによって多孔質絶縁膜 86 の表面を瞬間的に高温に晒してもよい。

#### 【0018】

図 3 は、本発明の実施の形態に係る多孔質絶縁膜の形成方法の概略工程フローチャートである。まず、図 3 のステップ 100 に示したように、ワーク 1 に絶縁材原料を溶解した溶液 22 を塗布する塗布工程を行なう。この溶液 22 は、例えば二酸化ケイ素や窒化ケイ素（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）などの無機絶縁材料の微粉末を溶解したものや、テトラエトキシシラン（TEOS）などのアルコキシド系化合物などの有機系絶縁材料を溶解したものからなっている。そして、溶液 22 は、溶液 22 を溶媒の融点以下に冷却して凝固膜 68 としたときに、凝固膜 68 がゲル状になることが望ましい。

#### 【0019】

溶液 22 のワーク 1 への塗布は、実施形態の場合、図 2 に示したスリットコート法によって行なう。このスリットコートにおいては、ワーク 1 は、図 2（1）に示してあるように、溶液塗布部 20 に設けたチャック 30 の下面に装着する。塗布ノズルであるキャピラリー 26 は、ワーク 1 に溶液 22 を塗布しない待機位置（初期位置）が、塗布液槽 24 内の溶液 22 中に没した状態となっている。

#### 【0020】

溶液 22 の塗布を開始する場合、同図（2）に示したように、蓋 38 を矢印 120 のように移動させて上端開口 36 を開放する。また、矢印 122 のようにキ

キャピラリー 26 を上昇させて上端（先端）を上端開口 36 から露出させるとともに、チャック 30 を矢印 124 のようにキャピラリー 26 に向けて移動させる。溶液 22 は、キャピラリー 26 の先端が液面から突出すると、毛細管現象によってキャピラリー 26 に吸い上げられ、表面張力によってキャピラリー 26 の先端から盛り上がった状態となる。

#### 【0021】

その後、キャピラリー 26 とワーク 1 との間に所定の微小間隙が形成されるようにキャピラリー 26 の上下方向の位置を調整する。そして、チャック 30 をさらに矢印 124 のように移動させ、図 2（3）に示したように、ワーク 1 の下面をキャピラリー 26 の上端から盛り上がっている溶液 22 に接触させる。そして、同図（4）に示したように、チャック 30 をさらに矢印 124 のように移動させてワーク 1 に溶液 22 を塗布し、ワーク 1 の下面に溶液 22 の塗布膜 126 を形成する。キャピラリー 26 からの溶液 22 の吐出量は、図示しないフレキシブルなパイプを介して接続した溶液タンクの上下位置を調整して制御される。また、溶液 22 の塗布膜 126 の厚は、溶液 22 の粘度、ワーク 1 の移動速度などによって調節される。

#### 【0022】

ワーク 1 が図 2（5）に示したようにキャピラリー 26 の上方を通過し終わると、矢印 128 のように溶液 22 の液面を下降させ、溶液 22 の塗布工程を終了する。そして、同図（6）に示したように、キャピラリー 26 を矢印 130 のように初期位置に下降させる。また、蓋 38 を矢印 132 のように移動させて上端開口 36 を閉鎖するとともに、塗布液槽 24 内に溶液 22 を補充し、液面を矢印 134 のように上昇させて初期位置に復帰させる。

#### 【0023】

このようにして溶液 22 の塗布膜 126 が形成されたワーク 1 は、図 3 のステップ 104 に示したように、凝固膜形成工程に搬入され、溶液 22 の溶媒の融点以下に冷却される。すなわち、ワーク 1 は、図 1 に示した真空乾燥部 60 の減圧室 62 内に設けてある冷却プレート 54 の上に配置される。冷却プレート 54 は、予め所定の温度に冷却してあって、ワーク 1 を介して塗布膜 126 を溶媒の融

点以下に急冷する。これにより、溶媒 22 にからなる塗布膜 126 は、その形状、厚さを保持した状態でいわゆる凍結されて固相となり、ゲル状の凝固膜 68 となる固体になる。

#### 【0024】

なお、使用する溶液 22 の粘度などの関係で、単に塗布膜 126 を凍結させただけでは所望の厚さを有する薄い絶縁膜を形成することができない場合、ステップ 102 の工程を行なって膜厚の調整をする。すなわち、塗布膜 126 は、溶媒が蒸発した量に応じて厚さが小さくなるので、予め溶媒ごとに温度と蒸発量との関係を求め、塗布膜 126 を形成したワーク 1 を所定の温度に所定時間保持して塗布膜 126 の厚さを調整したのち、冷却プレート 54 の上に配置して凝固膜 68 を形成する（ステップ 104）。これにより、非常に薄い多孔質絶縁膜の形成が可能となる。

#### 【0025】

溶液 22 を凍結させて凝固膜 68 にしたならば、真空ポンプ 66 によって減圧室 62 を減圧し、凝固膜 68 を減圧した状態で乾燥（いわゆる凍結真空乾燥）する真空乾燥工程を行なう。これにより、ゲル状の凝固膜 68 の内部から溶媒が気化し、凝固膜 68 が昇華乾燥されて膜厚、形状が保持された多孔質凝固膜 76 となる（ステップ 106）。所定時間の真空乾燥が終了したならば、ワーク 1 を焼成部に搬入し、多孔質凝固膜 76 の焼成を行なう。すなわち、ワーク 1 を焼成部 70 のホットプレートの上に配置し、多孔質凝固膜 76 を所定温度で所定時間加熱して多孔質凝固膜 76 を硬化する（ステップ 108）。これにより、絶縁材原料が例えば TEOS などのアルコキシド系化合物である場合、化合物が分解されて二酸化ケイ素の多孔質絶縁膜 86 となる。

#### 【0026】

このように形成した多孔質絶縁膜 86 は、空孔率が 90% 以上と極めて大きく、誘電率を小さくすることができる。ところが、多孔質絶縁膜 86 は、空孔率が非常に大きいため、多孔質絶縁膜 86 が薄い場合、通気性を有するようになり、空気中の水分の付着などにより、時間の経過とともに絶縁性能が劣化する。そこで、多孔質絶縁膜 86 に対してステップ 110 の気密処理を行なう。すなわち、

多孔質絶縁膜 86 を形成したワーク 1 を気密処理部 80 の処理室 82 に搬入し、フラッシュ装置 84 によって瞬間的に多孔質絶縁膜 86 の表面を高温に晒す。これにより、多孔質絶縁膜 86 の表層部が熔融し、表層部の空孔が塞がれて通気性が失われ、気密性を有する多孔質絶縁膜が完成する（ステップ 112）。

#### 【0027】

このように、実施の形態に係る多孔質絶縁膜の形成方法は、絶縁材原料を溶解した溶液 22 をワーク 1 に塗布して溶媒の融点以下に冷却し、いわゆる凍結真空乾燥して多孔質化したのち、焼成して硬化するようになっている。このため、多孔質絶縁膜の形成工程が簡素化され、処理時間を大幅に短縮することができる。また、得られる多孔質絶縁膜 86 は、空孔率が 90% 以上と非常に大きく、誘電率を小さくすることができる。しかも、ワーク 1 に溶液 22 を塗布してこれをいわゆる凍結真空乾燥するため、ワークの表面の凹凸を多孔質絶縁膜 86 の形成とともに平坦化することができる。さらに、実施形態においては、溶液 22 の塗布をスリットコートによって行なっているため、溶液 22 の利用効率を 96% 以上とすることができる。そして、実施形態に係る多孔質絶縁膜の形成方法によって半導体装置の層間絶縁膜などを形成すると、誘電率の小さな層間絶縁膜とすることができ、動作速度の速い電子デバイスとすることができる。また、多孔質絶縁膜による層間絶縁膜の形成工程において表面が平坦化されるため、従来必要としていた CMP などによる平坦化の工程を省くことができ、電子デバイスのコストを削減することができる。

#### 【0028】

##### 【実施例】

##### 《実施例 1》

ベンゼン（融点 5.53℃）に TEOS を 10 重量% 溶解して塗布用の溶液 22 を生成した。この溶液 22 を図 2 に示した塗布装置によって半導体基板（ワーク）にスリットコートし、半導体基板に厚さ約 200 nm の塗布膜 126 を形成した。そして、半導体基板を減圧室 62 内の冷却プレート 54 の上に配置して -30℃ に急冷し、TEOS のベンゼン溶液をゲル状の凝固膜 68 にした。その後、減圧室 62 を約 133 kPa（1 Torr）に減圧し、凝固膜 68 を 20 時間

真空乾燥して多孔質凝固膜 76 にした。その後、半導体基板をホットプレート 74 の上に配置し、300℃で5分間焼成を行なった。このようにして形成した多孔質絶縁膜 86 は、膜厚が約 200 nm、空孔率が 90% 以上であった。また、多孔質絶縁膜 86 の比誘電率を測定したところ、1.3 であった。しかし、焼成から 24 時間経過した時点で再度比誘電率を測定したところ、導通していた。

#### 【0029】

##### 《実施例 2》

TEOS を 10 重量% 溶解した TEOS のベンゼン溶液を生成し、実施例 1 と同様にして半導体基板に約 200 nm の多孔質絶縁膜 86 を形成した。次いで、多孔質絶縁膜 86 の表面をフラッシュ装置 84 を用いて 800℃ に 10 ms 晒し、多孔質絶縁膜 86 の気密処理を行なった。この多孔質絶縁膜 86 の比誘電率は 1.3 であった。また、24 時間経過した翌日に、比誘電率を再度測定したところ、1.3 と変化がなかった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図 1】 実施の形態に係る多孔質絶縁膜形成装置の概略構成図である。

【図 2】 実施の形態に係る溶液の塗布方法を説明する図である。

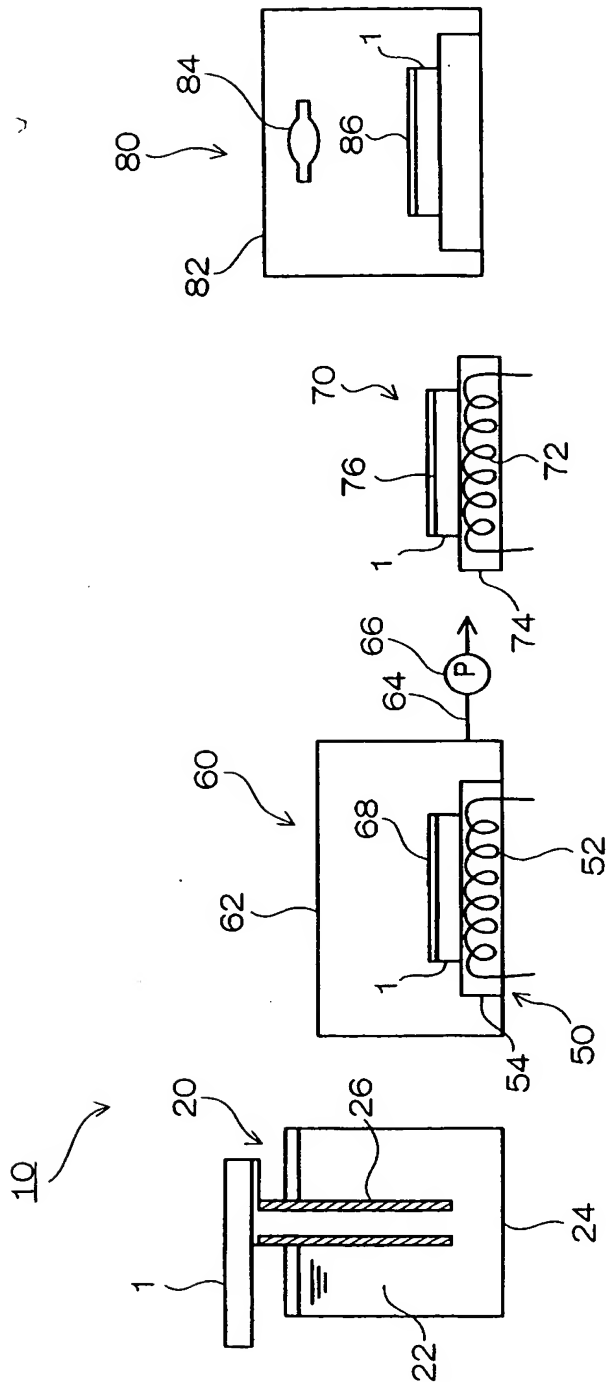
【図 3】 実施の形態に係る多孔質絶縁膜の形成方法のフローチャートである。

#### 【符号の説明】

1 ……ワーク、10 ……多孔質絶縁膜形成装置、20 ……溶液塗布部、22 ……溶液、26 ……キャピラリー、50 ……凝固膜形成部、54 ……冷却プレート、60 ……真空乾燥部、66 ……真空ポンプ、68 ……凝固膜、70 ……焼成部、74 ……ホットプレート、76 ……多孔質凝固膜、80 ……気密処理部、84 ……フラッシュ装置、86 ……多孔質絶縁膜。

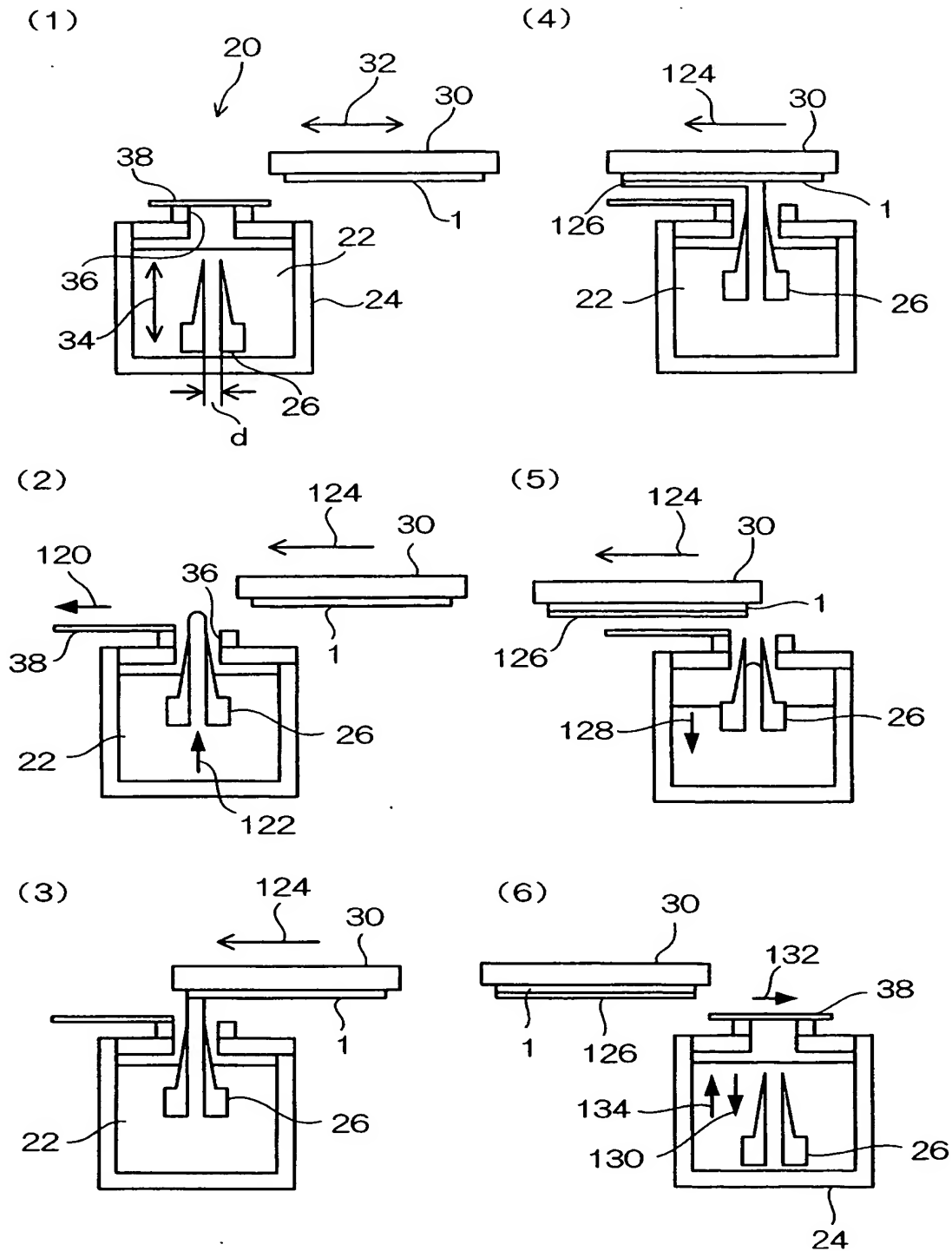
【書類名】 図面

【図 1】

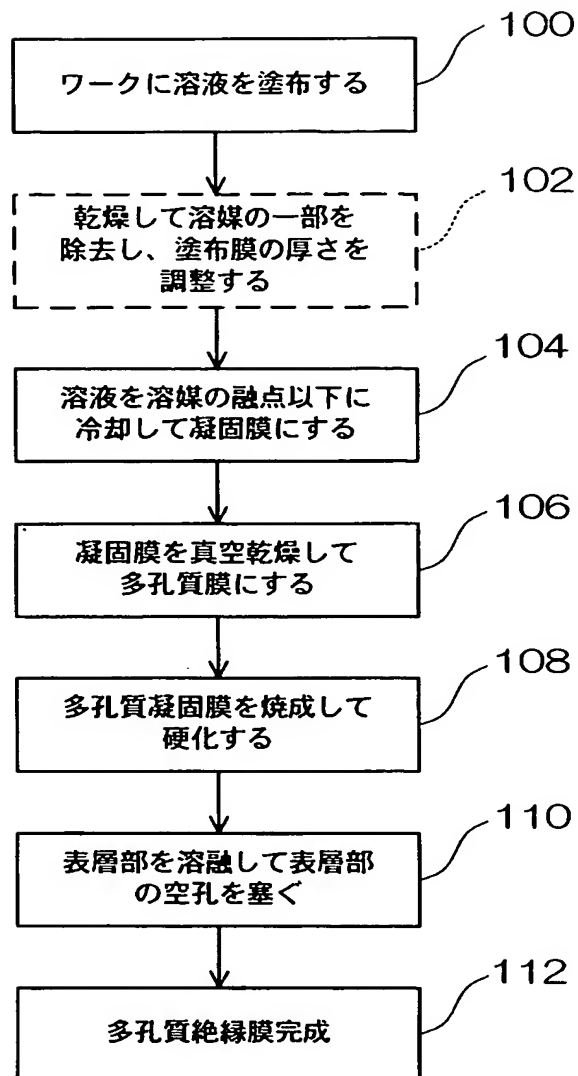


- |               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 1:ワーク         | 50:凝固膜形成部  | 80:気密処理部   |
| 10:多孔質絶縁膜形成装置 | 54:冷却プレート  | 84:フラッシュ装置 |
| 20:溶液塗布部      | 60:真空乾燥部   | 86:多孔質絶縁膜  |
| 22:溶液         | 62:減圧室     |            |
| 26:キャリアー      | 68:凝固膜     |            |
|               | 70:焼成部     |            |
|               | 74:ホットプレート |            |
|               | 76:多孔質凝固膜  |            |

【図 2】



【図 3】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多孔質絶縁膜を容易に形成できるようにする。

【解決手段】 多孔質絶縁膜形成装置 1 0 は、溶液塗布部 2 0、凝固膜形成部 5 0、真空乾燥部 6 0、焼成部 7 0、気密処理部 8 0 を有する。溶液塗布部 2 0 は、絶縁材原料を溶解した溶液 2 2 をワーク 1 に塗布する。凝固膜形成部 5 0 は、冷却プレート 5 4 によってワーク 1 に塗布した溶液 2 2 を溶媒の融点以下に冷却して凝固膜 6 8 にする。真空乾燥部 6 0 は、減圧室 6 2 が真空ポンプ 6 6 によって減圧され、凝固膜 6 8 中の溶媒を気化させて多孔質凝固膜 7 6 にする。焼成部 7 0 は、多孔質凝固膜 7 6 をホットプレート 7 4 によって焼成して硬化し、多孔質絶縁膜 8 6 にする。気密処理部 8 0 は、フラッシュ装置 8 4 が放射する熱線を多孔質絶縁膜 8 6 の表面に瞬間的に照射し、表層部を熔融して表層部の空孔を塞いで多孔質絶縁膜 8 6 に気密性を与える。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 0 0 1 8 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 3 6 9 ]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日  
新規登録

住 所  
氏 名

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号  
セイコーエプソン株式会社